



特性

- 》优异的导热率
- 》无毒环保安全，满足RoHS要求
- 》优秀的长期稳定性
- 》彻底填铺接触表面，创造低热阻
- 》不易挥发

应用

- 》微处理器
- 》图形处理芯片
- 》机顶盒
- 》LED电视 LED灯具
- 》笔记本

TIC® 800M 是由多种金属混合制成的新型相变化导热产品，专为解决散热难题与提升应用可靠性设计。该材料兼具高导热性能，且不易蒸发、安全无毒、物化性质稳定。当温度高于其相变温度时，材料会软化并发生相变，能够紧密填充器件表面微小的不规则接触面，形成低接触热阻的导热界面，从而实现优异的散热效果。

TIC® 800M 特性表		
产品特性	典型值	测试标准
颜色	银白色	目视
形态	片状固体	目视
结构&成份	铋合金	-
密度 (g/cm ³)	8.0	ASTM D792 @25°C
导热系数 (W/m·K)	18.9	ISO22007 @25°C
比热容 (J/g·°C)	0.24	ASTM E1269 @25°C
电阻率 (Ω·m)	< 10 ⁻⁴	ASTM D257
相变温度范围 (°C)	>60	ASTM D3418
凝固点范围 (°C)	< 57	ASTM D3418
建议使用温度范围 (°C)	-40~250	-

包装方式:

TIC® 800M可依据客户要求包装。

使用方式:

在使用本材料后，建议用适合的泡绵或垫片，沿着相变金属的边缘进行围固，确保材料不流散或扩散。

如想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

